

Microchip 社、量産向けにはんだレスの自動装着工程を実現する プレスフィット端子パワーモジュールを発表

SiC(シリコン カーバイド)または Si(シリコン)技術で柔軟に構成可能な Microchip 社の SP1F および SP3F パワーモジュールにプレスフィット端子オプションが登場

2023 年 12 月 7 日[NASDAQ: MCHP] - e モビリティ、持続可能性、データセンター市場では量産可能な製品が求められます。実装工程の自動化を促進するため、よく使われるのがプレスフィット端子で、これはパワーモジュールをはんだ付けしないでプリント基板に取り付けるソリューションを提供します。Microchip Technology Incorporated(日本法人: 東京都港区浜松町、代表: 櫛晴彦 以下 Microchip 社)は本日、量産アプリケーション向けに[プレスフィット端子](#)を備えた SP1F および SP3F パワーモジュールの幅広いポートフォリオを発表しました。

はんだレスのプレスフィット・パワーモジュール端子は、自動実装またはロボットによる実装を可能にし、組み立て工程の簡略化と時間短縮、ひいては製造コストの削減を実現します。SP1F および SP3F パワーモジュールでは正確な端子位置と革新的なプレスフィット端子の設計によってプリント基板との信頼性の高い接合が確保されます。総合的に見て、プレスフィット・パワーモジュール ソリューションを使うと貴重な時間と製造コストを節約できます。

Microchip 社の SP1F および SP3F パワーモジュール ポートフォリオは、mSiC™技術または Si 半導体を使うオプション、多数のトポロジと定格を備えた 200 以上のバリエーションを揃えています。SP1F と SP3F は 600~1700 V の電圧レンジ、最大電流 280 A で提供しています。

プレスフィット技術の採用で、パワーモジュールの端子のプリント基板へのはんだ付けはなくなり、プリント基板上の適切なサイズの穴に端子を圧入する事で電氣的接続が得られるようになります。プレスフィット・パワーモジュール ソリューションの大きな利点の 1 つが、ウェーブはんだ付けが不要になる事です。これは、SMT(表面実装)部品も搭載するように設計されているプリント基板の場合に特に重要です。

「Microchip 社のプレスフィット端子を備えたパワーモジュールはお客様が設計を完全にカスタマイズできる柔軟性を提供する、量産向けのコスト効率に優れたパワーソリューションです」と Microchip 社ディスクリート製品部門副社長の Leon Gross は述べています。「この種のプラグアンドプレイ パワー ソリューションは、自動組み立てまたはロボットによる組み立てに適した信頼性の高い実装ソリューションも実現します」。

SP1F および SP3F パワーモジュールは柔軟な構成が可能で RoHS(特定有害物質使用制限指令)に完全に準拠しています。

Microchip 社、量産向けにはんだレスの自動装着工程を実現するプレスフィット端子パワーモジュールを発表

2-2-2-2

補足と参考資料

[アプリケーション ノート AN4322](#) に SP1F および SP3F プレスフィット パワーモジュールの詳細な実装手順を記載しています。

在庫/供給状況

Microchip 社の SP1F および SP3F パワーモジュールのプレスフィット端子オプションは本日より受注を開始いたします。詳細とご購入は Microchip 社の正規代理店にお問い合わせ頂くか、Microchip 社のオンラインストアのウェブサイト www.microchipdirect.com をご覧ください。

リソース

高画質の写真は報道関係専用窓口までお問い合わせ頂くか、Flickr でご覧ください。掲載に許可は不要です。

- アプリケーション画像: www.flickr.com/photos/microchiptechnology/53334254890/sizes/

Microchip Technology 社について:

Microchip Technology 社(以下、Microchip 社)はスマート、コネクテッド、セキュアな組み込み制御ソリューションのトッププロバイダです。使いやすい開発ツールと包括的な製品ポートフォリオにより、リスクを低減する最適な設計を作成し、総システムコストの削減、迅速な商品化を実現できます。Microchip 社は産業、車載、民生、航空宇宙と防衛、通信、コンピューティングの市場で 125,000 社を超えるお客様にソリューションを提供しています。Microchip 社は本社をアリゾナ州チャンドラーに構え、優れた技術サポート、確かな納期、高い品質を提供しています。詳細は Microchip 社ウェブサイト(www.microchip.com)をご覧ください。

###

Note: Microchip 社の名称とロゴ、Microchip ロゴは米国およびその他の国における Microchip Technology Incorporated の登録商標です。mSiC は米国およびその他の国における Microchip Technology Incorporated の商標です。その他の商標は各社に帰属します。

詳細については、以下にお問い合わせください。
Daphne Yuen (Microchip 社): (852) 2943 5115
(メール: daphne.yuen@microchip.com)

松田、仙場 (共同 PR): (03) 6260 4863
(メール: mchp-pr@kyodo-pr.co.jp)

報道関係者の方へ: このニュースリリースのメールによる配信については、共同 PR 株式会社 松田もしくは仙場まで電話(03) 6260 4863 またはメール mchp-pr@kyodo-pr.co.jp でお問い合わせください。